



Przeznaczenie

Klej żelowy MITECH KE FLEX przeznaczony jest do przyklejania płytek ceramicznych, nasiąkliwych i nie nasiąkliwych, kamiennych na typowych podłożach mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Polecany do klejenia płytek w miejscach narażonych na trudne warunki użytkowe i zmienne warunki atmosferyczne. Do klejenia płytek na ogrzewaniu podłogowym, na hydroizolacji, na tarasach i balkonach, do płytek o wielkim formacie. Zastosowana w składzie kleju technologia żelowa pozwala na dopasowanie odpowiedniej konsystencji kleju, daje znacznie większy zakres dozowania wody w porównaniu ze standardowym klejem cementowym. W zależności od potrzeb wykonawczych, możemy uzyskać zwiększony rozplływ zaprawy klejącej, optymalizując w ten sposób przyczepność połączenia szczególnie na powierzchniach poziomych. Zwiększona ilość wody zarobowej pozwala również na bezpieczne klejenie płytek i wysychanie kleju na balkonach i tarasach podczas bezpośredniego działania słońca. Optymalne rozłożenie zaprawy klejącej uzyskujemy również nakładając klej o odpowiedniej konsystencji na płytki wielkoformatowe. Ograniczony spływ pozwala na klejenie płytek ceramicznych od góry. Po dobraniu odpowiedniej konsystencji kleju, uzyskujemy możliwość do nakładania zaprawy klejącej o zróżnicowanej grubości nałożonej warstwy od 2 do 15 mm daje to możliwość na, cienkowarstwowe klejenie okładzin na podłożach równych, na szpachlowanie nierównego podłoża oraz na grubowarstwowe nałożenie kleju na podłożach nierównych bez konieczności szpachlowania.

Przygotowanie podłoża

Zalecanymi podłożami dla zaprawy klejowej żelowej MITECH FLEX są: tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe, posadzki i jastrychy cementowe lub anhydrytowe, mury z cegły, pustaka ceramicznego lub komórkowego, płyty OSB (po odpowiednim przygotowaniu), hydroizolacja. Każde podłoże powinno być nośne, równe, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych tj. brudu, kurzu, pyłu, tłustych zabrudzeń i bitumów oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Algi i grzyby należy usunąć za pomocą preparatu do usuwania alg i grzybów MITECH GLOMIX (patrz karta techniczna produktu) zmyć i pozostawić do wyschnięcia. Podłoża o słabej przyczepności tj. odspojone tynki i powłoki malarskie, w tym powłoki z farb kredowych należy usunąć. Chłonne podłoża zagruntować preparatem głęboko penetrującym MITECH MG. Podłoża o słabej przyczepności, nisko nasiąkliwe zagruntować gruntem szcpeym MITECH BETONGRUNT (patrz karta techniczna produktu). Hydroizolację wykonać zgodnie

z zaleceniami w karcie technicznej produktu, odpowiednio sezonować.

Sposób użycia

Do pojemnika na zaprawę klejową wlać 6,5–8,25 l wody, następnie wsypać 25 kg zaprawy klejowej. Mieszać wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odczekać 5-10 minut i powtórnie wymieszać. Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do użycia. Gotową masę klejową rozprowadzić równomiernie na podłożu za pomocą pacy zębatej, wielkość zębów powinna być dobrana do wielkości układanych płytek (np. dla płytki 10x10 cm – 6 mm, 20x25 – 8 mm, 30 x 30cm – 8 mm, 30x60 cm – 10 cm, 50x50 – 10 mm, 60x60 – 12 mm). Zaraz po jej nałożeniu układać płytki starannie je dociskając. Nadmiar kleju wypływający w spoinach należy usuwać na bieżąco. Temperatura podczas nakładania i wysychania kleju powinna wynosić od +5°C do +25°C. Klej powinien pokrywać minimum 80% powierzchni płytki. Przy klejeniu płytek ceramicznych na tarasach, balkonach, na ogrzewanie podłogowe, płytek dużego formatu klej należy nanieść na podłoże oraz na klejoną płytkę, klej powinien pokryć 100% powierzchni płytki. Możliwa jest korekta ustawienia płytki, której czas wynosi maksymalnie 20 minut.

Zalecenia wykonawcze

Spoinowanie przyklejonych płytek wykonać po minimum 24 godzinach schnięcia. W przypadku podłoża z płyt kartonowo – gipsowych, drewnopochodnych oraz gazobetonu należy je koniecznie zagruntować w celu zmniejszenia ich chłonności preparatem głęboko penetrującym MITECH MG. Na nowo wykonanych podłożach mineralnych tj. beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie kleju po minimum 3–4 tygodniach od wykonania podłoża. Na trudne podłoża tj: powłoki malarskie na bazie tworzyw sztucznych, płyty OSB, powierzchnie szkliste lastriko, glazurę stosować preparat gruntujący MITECH BETONGRUNT. Nie należy moczyć płytek przed ich przyklejeniem. Jeżeli klej został nałożony na większą powierzchnię, a płytki nie zostały przyklejone w ciągu 30 minut, należy sprawdzić jego zdolność do klejenia przez dotknięcie jego powierzchni suchą dłońią. Jeżeli klej nie brudzi rąk to należy go zdjąć ze ściany i nałożyć świeży. Optymalną rozplwyłość kleju otrzymuje się przy dozowaniu maksymalnej ilości wody tj: 8,25 l na 25 kg. Brak spływu kleju uzyskuje się przy minimalnym dozowaniu wody tj: 6,5 l na 25 kg. Proces aplikacji i wiązania kleju powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +30°C oraz przy stabilnej wilgotności powietrza. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania kleju. Należy pamiętać o właściwym wykonaniu i wykończeniu dylatacji występujących w podłożu, standardowo dylatacja powinna być podzielona na pola o powierzchni 3x3m. Po zakończeniu prac narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po wyschnięciu kleju czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką. Stężącej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać wodą ani świeżą zaprawą. Wszystkie podane parametry techniczne odnoszą się do znormalizowanych warunków wiązania tj: temperatury +23°C (±2°C) i wilgotności względnej powietrza 55% (±5%). W przypadku potrzeby użycia kleju w innych

zastosowaniach niż podane w karcie technicznej oraz w razie wszelkich wątpliwości należy skontaktować się z działem technicznym MITECH. Zalecenia zawarte w karcie technicznej produktu nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Dane techniczne

temperatura stosowania	+5°C - +30°C
temperatura podłoża	+5°C - +30°C
proporcje mieszania	6,25-8,25 l na 25 kg
możliwość korekty	20 minut
grubość warstwy kleju	od 2 do 15 mm
czas zużycia wymieszanego kleju	2 godziny
czas schnięcia	24 godziny
spoinowanie podłoga ściany	24 godziny 12 godzin
kolor	szary
gęstość nasypowa	ok 1,4 g/cm ³
przyczepność początkowa	≥ 1 MPa
po zanurzeniu w wodzie	≥ 1 MPa
po starzeniu termicznym	≥ 1 MPa
po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1 MPa
odporność na temperaturę	od -25°C do +70°C
pełne obciążenie eksploatacyjne	
ruch pieszy	po 3 dniach
ruch kołowy	po 14 dniach
ogrzewanie podłogowe - wygrzewanie	po 14 dniach
odporność na ogień	A1
zużycie na m ²	około 1 – 1,2 kg na każdy mm grubości
przechowywanie	12 miesięcy, w warunkach suchych, chronić przed wilgocią
wymagania prawne	PN-EN 12004:2012+A1 DWU nr KZ/ 6772
opakowania	25 kg, paleta 48 szt, 1200 kg
potrzebne narzędzia	mieszarka wolnoobrotowa, paca zębata, szpachla, poziomnica
mycie narzędzi	woda
środki ostrożności	patrz karta charakterystyki

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w karcie technicznej zostały przygotowane na podstawie długoletnich doświadczeń producenta. Jednakże firma nie ma wpływu na warunki przechowywania, transportu po opuszczeniu fabryki oraz warunków i sposobu stosowania produktu, dlatego też zawarte informacje w karcie technicznej nie mogą być podstawą do roszczeń gwarancyjnych w sensie prawnym w przypadku użycia produktów niezgodnie z jego przeznaczeniem. Producent ma prawo do uzupełniania danych lub ich zmiany bez uprzedniego powiadomienia